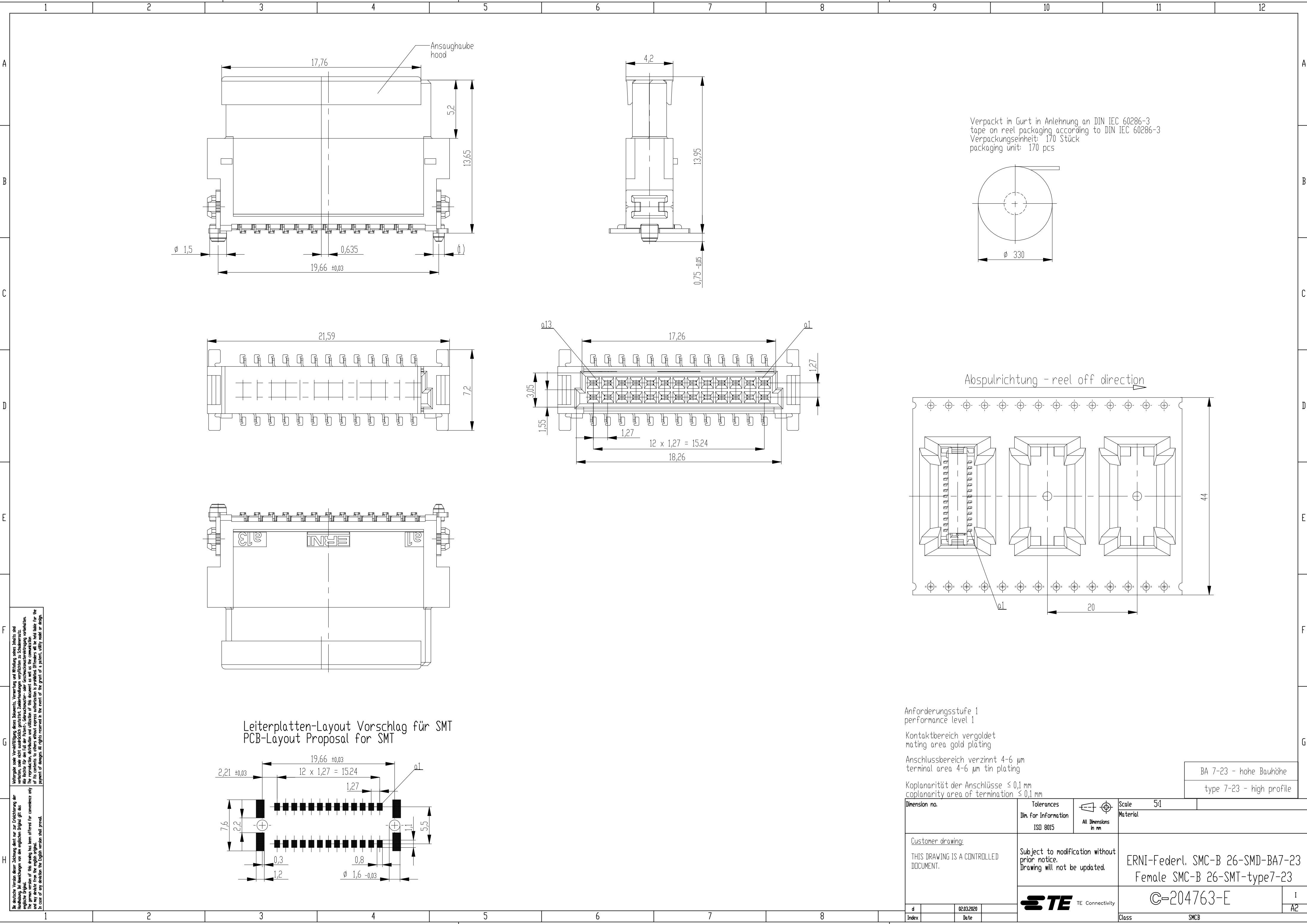
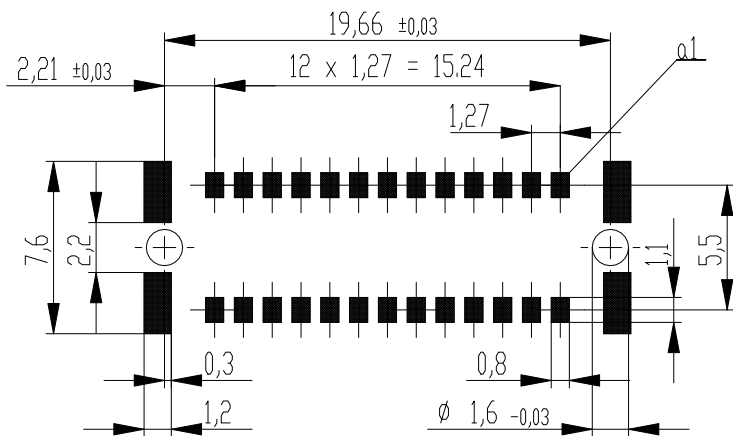


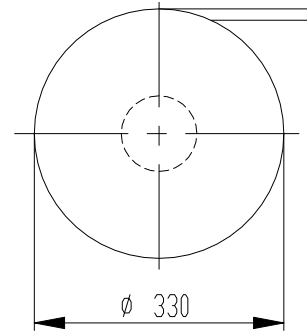


Alle deutschen Versionen dieser Zeichnung dienen nur zur Erleichterung der
Handhabung bei Änderungen von den englischen Originalen. Die
englische Fassung ist die verbindliche. Änderungen der deutschen
Versionen sind ohne schriftliche Genehmigung der englischen
Originalen nicht zulässig. In case of any deviation the English version shall prevail.

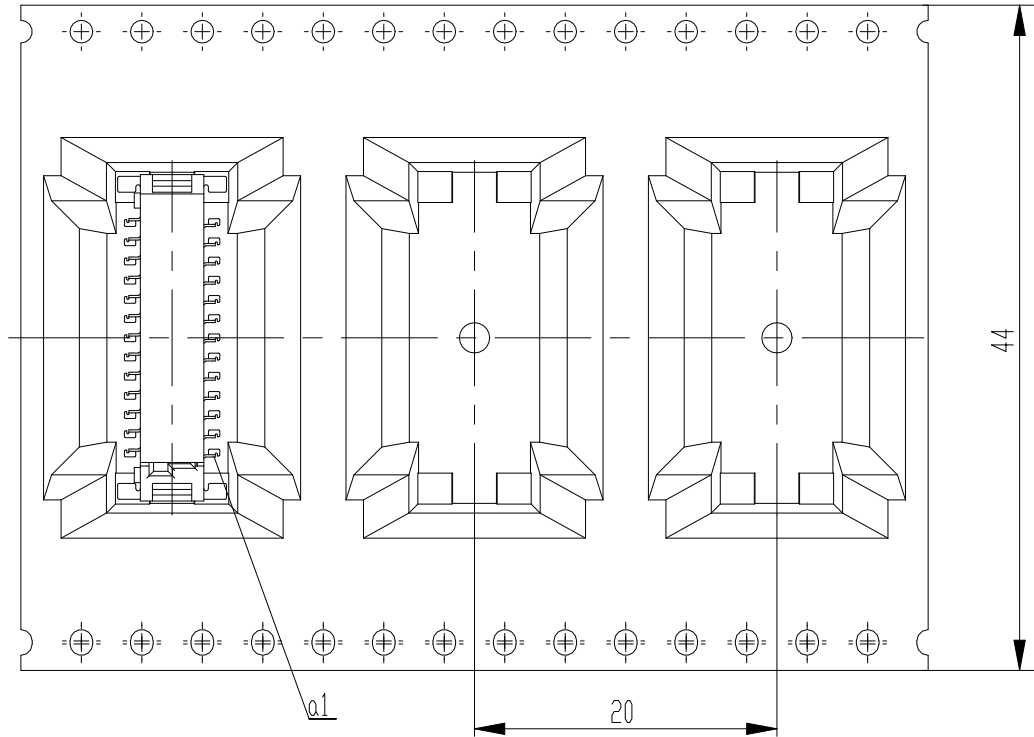
Leiterplatten-Layout Vorschlag für SMT PCB-Layout Proposal for SMT



Verpackt im Gurt in Anlehnung an DIN IEC 60286-3
tape on reel packaging according to DIN IEC 60286-3
Verpackungseinheit: 170 Stück
packaging unit: 170 pcs



Abspulrichtung - reel off direction



Anforderungsstufe 1
performance level 1

Kontaktbereich vergoldet
mating area gold plating

Anschlussbereich verzinkt 4-6 µm
terminal area 4-6 µm tin plating

Koplanarität der Anschlüsse ≤ 0,1 mm
coplanarity area of termination ≤ 0,1 mm

BA 7-23 - hohe Bauhöhe
type 7-23 - high profile

Dimension no.		Tolerances Din. for Information ISO 8015	 All Dimensions in mm	Scale Material	5:1
Customer drawing: THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		ERNI-Federl. SMC-B 26-SMD-BA7-23 Female SMC-B 26-SMT-type7-23	
 TE Connectivity		©-204763-E		1 A2	
d Index	02.03.2020 Date			Class	SMCB